

ULVAC

株式会社 アルバック

決算説明資料

2021年度 第1四半期 2021年7月~2021年9月

2021年11月12日

証券コード：6728

Breakthrough 2022

将来見通しに関する記述についての注意事項

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。

世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。



1. 受注高は半導体・電子・FPD関連が引き続き好調、前年同期比倍増

- 半導体 : ロジック・メモリ需要拡大・微細化進展 (前年同期比**3.8**倍)
- 電子 : スマート社会進展に伴うエレクトロニクス市場拡大、中国の国産化投資活発化 (同**1.8**倍)
- F P D : LCD投資の継続、OLEDシフトの進展等により高水準で推移 (同**3.9**倍)

2. 売上高・営業利益も前年同期比増加

	前年同期	1Q実績	前年同期比
□受注高	312億円	663億円	+351億円 (+112%)
□売上高	366億円	474億円	+109億円 (+30%)
□営業利益	10億円	36億円	+26億円 (+261%)

本日、第1四半期の決算を発表しました。

そのポイントは、

半導体・電子・FPD関連の投資が高水準で推移し、受注高は663億円と前年同期312億円比倍増しました。

半導体は、ロジック・メモリともに需要が拡大するとともに、微細化が進展し、設備投資が拡大しており、受注高は前年同期比3.8倍となりました。

電子については、スマート社会進展に伴いパワーデバイス・オプトデバイス関連などエレクトロニクス市場が拡大するとともに、中国の国産化投資も活発化し、受注高は前年同期比1.8倍となりました。

FPDについては、LCD投資が高水準で継続するとともに、LCDからOLEDへのシフトのための投資も進み、受注高は3.9倍となりました。

売上高は、前年同期比109億円増加し、30%増の474億円

営業利益は、26億円増加し、3.6倍の36億円

となりました。

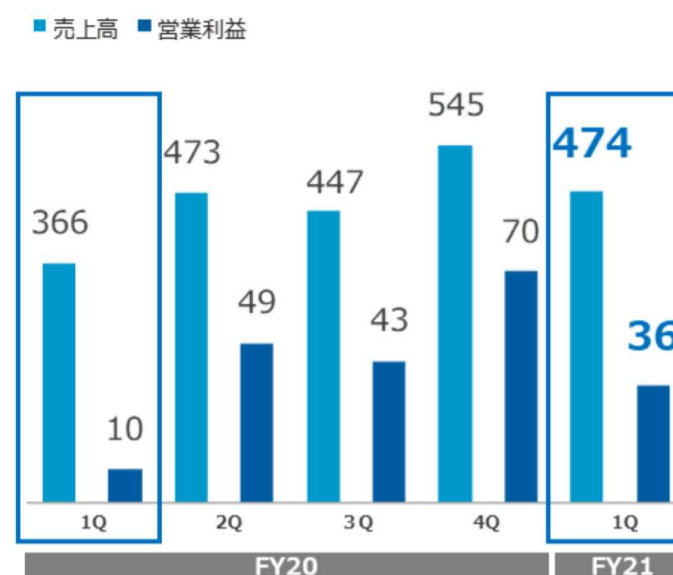
経常利益・当期純利益も増加しています。

- ロジック・メモリ投資やエレクトロニクス関連投資、LCD投資継続等により、受注高は高水準（前年同期比倍増）
- 売上高・営業利益も前年同期比増加

【単位：億円】	2020年度 1Q		2021年度 1Q	
	実績		実績	前年同期比
受注高	312		663	+351
売上高	366		474	+109
売上総利益	94		132	+38
率	25.7%		27.9%	+2.2pt
販管費	84		97	+13
営業利益	10		36	+26
率	2.7%		7.5%	+4.8pt
経常利益	10		35	+25
率	2.8%		7.4%	+4.6pt
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3		22	+19
率	0.9%		4.7%	+3.8pt

売上高と営業利益の推移

【単位：億円】



ロジック・メモリ・エレクトロニクス関連・LCD投資などが好調で、受注高は663億円と前年同期比351億円増加し、2.1倍となりました。

売上高も、109億円増加の474億円となりました。

営業利益・経常利益・当期純利益ともに前年同期を上回りました。

- 半導体は、需要拡大・ロジック分野のMHM^{*}工程採用増・他工程参入で成長
- 電子は、化合物での実績、中国の国産化投資活発化に対応した技術営業力強化で成長
- FPDは、LCD投資の継続、OLEDシフトの進展等により高水準で推移

品目	主要製品分野	投資動向	主要ドライバー	市場の拡大
半導体	・ ロジック	↗	・ MHM工程採用増 ・ 他工程参入	<ul style="list-style-type: none"> ・ DX(デジタルトランスフォーメーション)・ICT(情報通信)加速化 ・ リモート活用の常態化 ・ 自動車のEV化 ・ AIの活用拡大 ・ 地政学リスク・サプライチェーン
	・ メモリ	↗	・ 配線工程での実績	
電子	・ パワーデバイス	↗	<ul style="list-style-type: none"> ・ 化合物での実績 ・ 中国国産化・技術営業力 	
	・ オプトデバイス			
	・ 通信デバイス			
FPD	・ LCD	→	・ スパッタ装置シェアNo1維持	
	・ OLED	↗	・ 大型基板化でシェアアップ	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ コンポーネント ・ マテリアル ・ カスタマーサポート 	→	・ 装置との連携	

技術革新

- ・ ロジック・メモリの微細化・大容量化・低消費電力化
- ・ パワー・オプト・通信デバイスの微細化・高性能化
- ・ ディスプレイの高精細化・フレキシブル化・大型化・低消費電力化

※EUV露光装置に対応したメタルハードマスク (MHM) 工程
© 2021 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information

Breakthrough 2022

5

まず、市場動向についてご説明します。

デジタルトランスフォーメーションや情報通信の加速化、リモート活用の常態化、地球温暖化対策への取組み強化に伴う自動車のEV化の加速化、AIの活用拡大などに加え、米中貿易摩擦下で半導体や電子部品等の工場の自国誘致・国産化加速など地政学リスクに対応したサプライチェーン再構築の動きなどにより、半導体・電子・FPD関連の設備投資市場は拡大しています。

加えて、ロジック・メモリの微細化や大容量化・低消費電力化、パワー・オプト・通信デバイスの微細化や高性能化、ディスプレイの高精細化やフレキシブル化・大型化・低消費電力化など技術革新が進み設備投資ニーズが拡大しています。

ロジックは、ファウンドリーの微細化投資が今年に入ってから更に活発化しており、1社目に続いて2社目のお客様の投資も今後、活発化し始めます。ノードが更に微細化する中で、EUV露光装置による微細化に伴い必要となるMHM工程の採用工程が増加し、またMHM工程の装置の高い評価を背景に他工程への参入機会も増加していますのでシェアもアップしていく予定です。

メモリ投資も引き続き高水準で推移しています。

パワー・オプト・通信デバイスも市場拡大に伴う日本企業の投資が引き続き高水準で続いており市場拡大とともに成長していきます。中国の国産化に向けた投資の動きも活発化しており、部長クラスのエンジニアが中国各地の工場を訪問し技術営業力を生かして成長を続けます。

LCDはタブレットやPC、車載用・医療用・ゲーム用などIT用のニーズに応える形で投資が継続しており、スパッタリング装置でシェアNo1を維持し続けます。また、OLEDパネルの活用範囲もモバイルやTV用からタブレット向けなどに拡大しており、設備投資も高水準で推移しています。

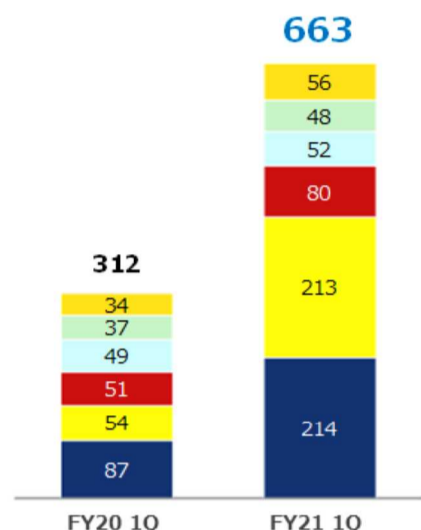
OLEDの大型基板化は大型スパッタ装置でシェアの高いアルバックにとって大きなチャンスでもあり、シェアアップにつなげていきたいと考えています。

コンポーネントやマテリアル、カスタマーサポートは装置と連携して堅調に推移しています。

- 半導体・電子・FPDの投資活発化等により、受注高は前年同期比倍増（部品長納期化に対応した前倒し受注あり）
- 売上高は、半導体・電子を中心に前年同期比増加

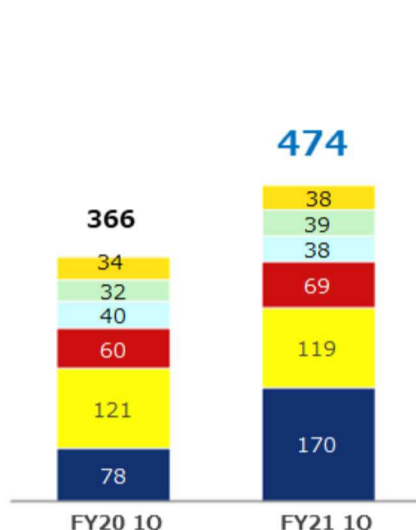
受注高 【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料
■ FPD製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



売上高 【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料
■ FPD製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



半導体・電子

半導体
ロジック投資活発化・メモリ投資継続

電子部品
パワー・オプト・通信デバイス等エレクトロニクス市場
拡大・中国国産化投資活発化

FPD

LCD投資継続

モバイル用OLED投資継続
⇒タブレット・PC等ITパネルに用途拡大

左は受注高の品目別のグラフです。

半導体電子が、87億円から214億円に2.5倍に増加し、FPDが54億円から213億円に3.9倍に増加するなど、全ての品目で前年同期を上回り、663億円と倍増しました。

部品長納期化への対応として、早めに発注をする顧客もあり、当初計画よりも前倒しで受注が進んでいます。

売上高は半導体電子が78億円から170億円に2.2倍に増加するなど、366億円から474億円に増加しました。

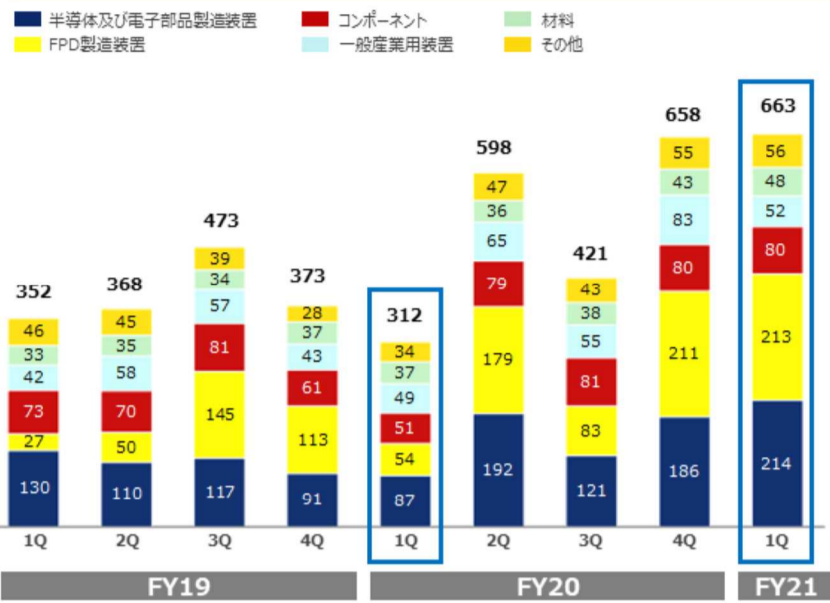
FPDのリードタイムが長いこと、部品長納期化への対応で前倒し受注した案件もあり、売上貢献に時間がかかるものもあることなどから、売上高に高水準の受注高が貢献するのは2Qから下期にかけてになります。

8月の開示時に、第1四半期の売上高について、会計基準の変更に伴い、売上高が第2四半期より低めに推移するとご説明しましたが、結果的には、検収が早まったことなどにより、社内想定よりも高い水準の売上高となりました。

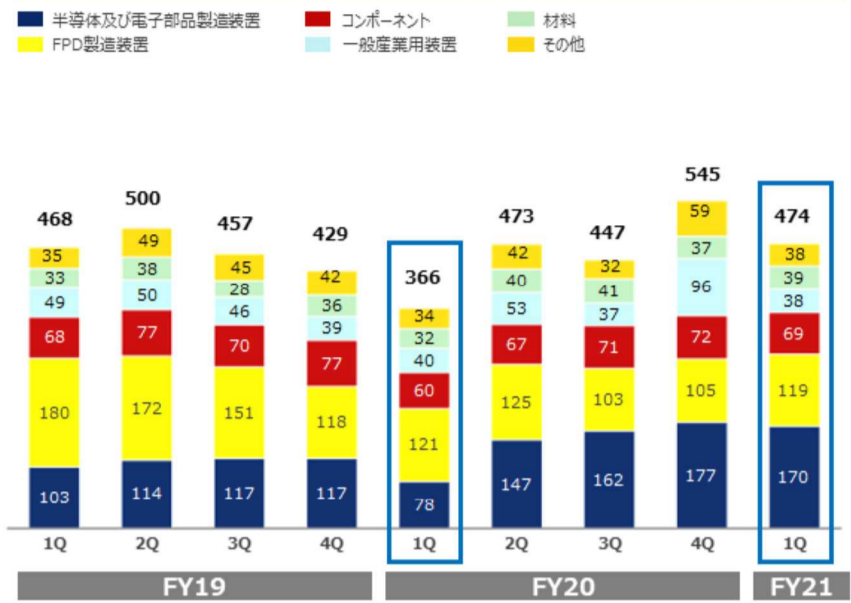
受注高は高水準で推移

- 半導体・電子・FPD関連が引き続き好調で受注高は高水準で推移

受注高 【単位：億円】



売上高 【単位：億円】



P7をご覧ください。受注高・売上高の四半期推移となります。

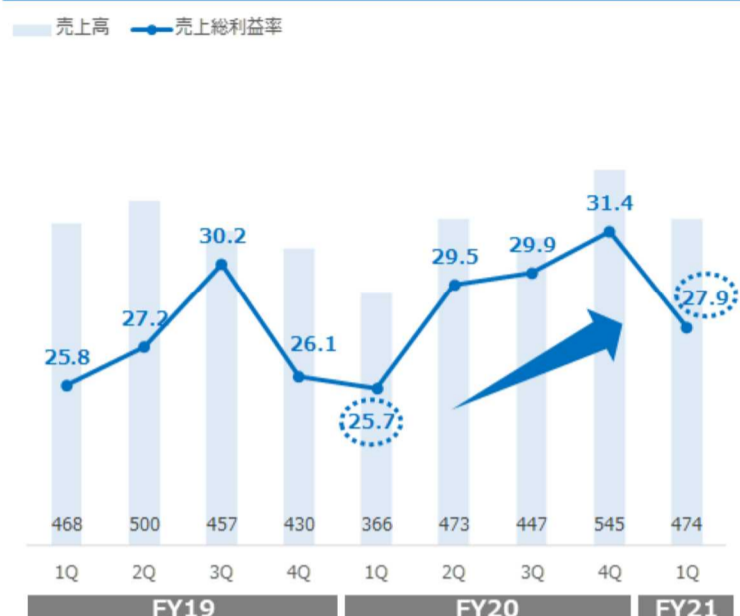
受注高は、半導体電子・FPDを中心に前期第4四半期から650億円を超える高水準で推移しています。

売上高は、半導体電子を中心に前期第2四半期から高水準で推移しており、受注の好調を受けて下期は更に増加する見込みです。

利益率は前年同期比改善

- 売上総利益率・営業利益率ともに前年同期比改善（前四半期比、売上高低下等により一時的に低下）

売上総利益率 【単位：億円、%】



営業利益率 【単位：億円、%】



P8をご覧ください。

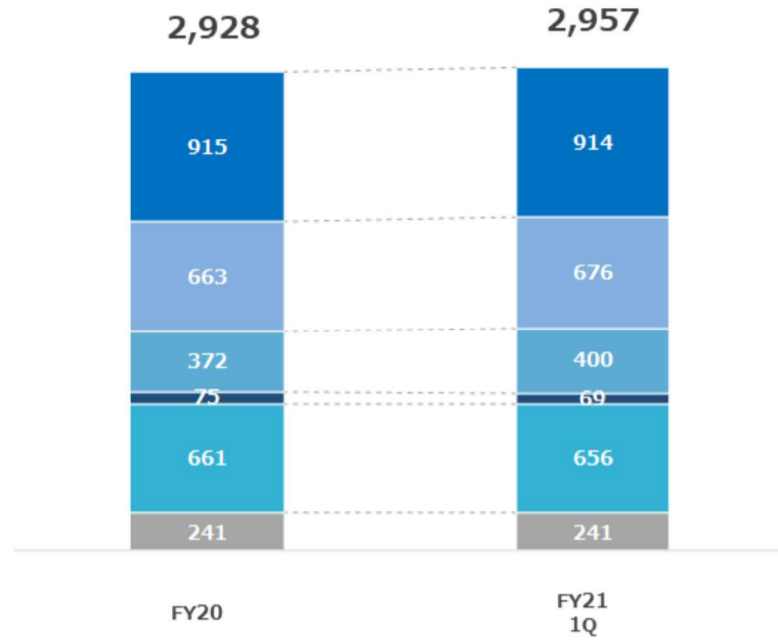
前年同期と比較すると、売上総利益率は25.7%から27.9%に、営業利益率は2.7%から7.5%にそれぞれ改善しています。

前期第4四半期と比較しますと、売上高が545億円から474億円に低下したことに加え、一部利益率の低い案件の売上もあり、一時的に低下していますが、第2四半期以降は売上高の回復と利益率の低い案件の影響が無くなることから、計画通りの利益計上を見込んでおり、通期および上期計画に変更はありません。

連結貸借対照表

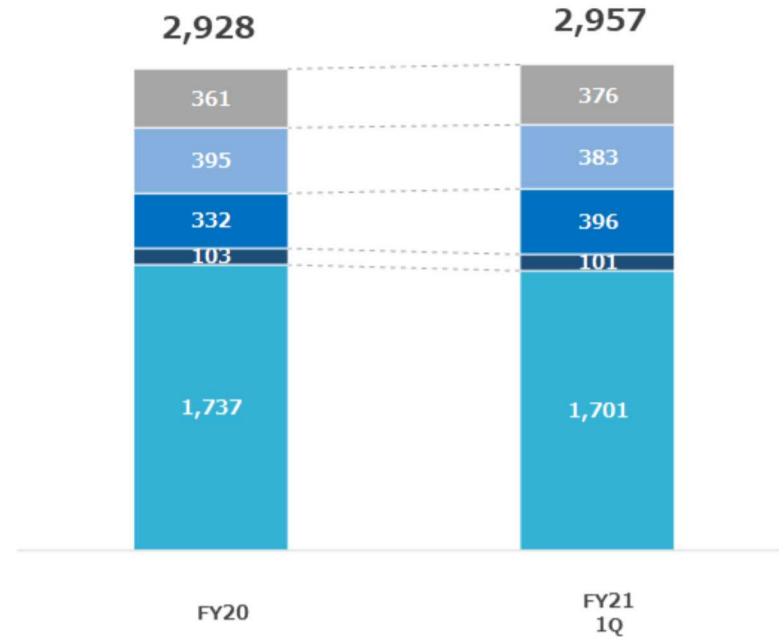
資産 【単位：億円】

- 投資有価証券 他 ■ 有形固定資産 ■ その他の流動資産
- 棚卸資産 ■ 受取手形・売掛金 ■ 現金・預金



負債・純資産 【単位：億円】

- 純資産 ■ その他固定負債 ■ その他流動負債
- 有利子負債 ■ 支払手形・買掛金



P9は貸借対照表をお示していますのでご覧ください。

国立大学法人東京工業大学と 「アルバック先進技術協働研究拠点」を設置 －真空装置の高性能化を目指して－

株式会社アルバックと国立大学法人東京工業大学は、2021年9月、「アルバック先進技術協働研究拠点」を東工大大岡山キャンパス内に設置しました。

開設時のテーマとしてプラズマ計測技術やAI技術に関して共同で研究を進めます。

また、共同研究のみにとどまらず人材育成なども含めた幅広いつながりで、アルバックと東京工業大学双方の発展につなげていきます。



写真左からアルバック 代表取締役社長 岩下 節生、東工大 益一 茂学長

国連グローバル・コンパクトに署名

国際連合が提唱する「国連グローバル・コンパクト」の趣旨に賛同・署名し、2021年9月、参加企業として登録されました。併せて、「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン」に加入しました。

アルバックグループはこれまで、「真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、産業と科学の発展に貢献することを目指す」という経営基本理念を基にサステナビリティ方針を策定し、人々の暮らしに不可欠な基礎技術である「真空技術」による価値提供を通じて、より安全、安心かつ豊かな社会の実現に取り組んできました。

今回の署名により、国連グローバル・コンパクトの10原則を遵守・実践し、グローバル企業として責任ある経営をより一層推進するとともに、顧客とともに主要な社会・環境課題の解決に貢献し続けます。



P10をご覧ください。

今年9月に東京工業大学大岡山キャンパス内に「アルバック先進技術共同研究拠点」を設置し、プラズマ計測技術やAI技術を活用した真空装置の高機能化に向けた共同研究を進めることとなりました。

同じく9月に「国連グローバル・コンパクト」の主旨に賛同・署名し、参加企業として登録されました。

国連グローバル・コンパクトの10原則を遵守・実践し、グローバル企業として責任ある経営をより一層推進するとともに、社会・環境課題の解決に貢献し続けていきます。

ご説明は以上です。
ご清聴ありがとうございました。

【単位：億円】	2020年度				2021年度		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期比	
						増減額	増減率
受注高	312	598	421	658	663	+351	+112%
売上高	366	473	447	545	474	+109	+30%
売上総利益	94	139	134	171	132	+38	+41%
率	25.7%	29.5%	29.9%	31.4%	27.9%	+2.2pt	
販管費	84	91	90	101	97	+13	+15%
営業利益	10	49	43	70	36	+26	+261%
率	2.7%	10.3%	9.6%	12.9%	7.5%	+4.8pt	
経常利益	10	50	41	78	35	+25	+242%
率	2.8%	10.6%	9.2%	14.4%	7.4%	+4.6pt	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3	42	37	66	22	+19	+589%
率	0.9%	8.9%	8.3%	6.7%	4.7%	+3.8pt	

さまざまな業界・用途で貢献する アルバックの真空技術



ULVAC